**新产品软固件方案设计书**

**项目编号**：

**项目名称**：

**拟制： 审核： 批准：**

***文 件 控 制***

**变更记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 作者 | 版本 | 更改说明 |
|  |  | A/0 | 首次发布 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**审阅**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 审阅者 | 意见 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**分发**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 接收人 | 地点 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

目录

[1.需求概述 4](#_Toc21816)

[1.1新产品描述 4](#_Toc28897)

[1.2现有产品缺陷 4](#_Toc17467)

[1.3客户需求 4](#_Toc23451)

[2.软/固件方案 4](#_Toc5093)

[2.1软件架构 4](#_Toc6075)

[2.2开发环境 4](#_Toc20044)

# 1.需求概述（*一级标题，宋体，三号，加粗*）

（正文，宋体，小四，首行缩进2个字符，行距20磅）

## 1.1新产品描述（*二级标题，宋体，四号，加粗*）

**1.1.1（三***级标题，宋体，小四，加粗正文，宋体，五号***）**

## 1.2现有产品缺陷

## 1.3客户需求

# 2.软/固件方案

## 2.1软件架构

## 2.2开发环境